

# Produktdatenblatt



GDM30SI30

Gabriel-Chip *Funktelefon & Babyphone*

## Einsatzbereich

- DECT-Funktelefon Sender & Empfänger
- Babyphone Sender & Empfänger

## Produktplatzierung

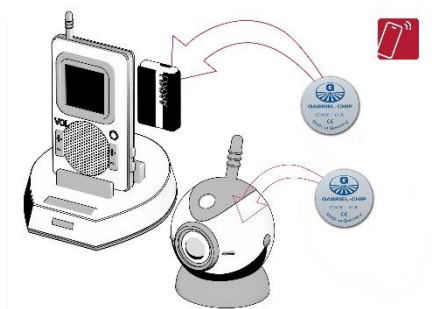
### DECT-Funktelefon Sender & Empfänger

Kleben Sie einen Gabriel-Chip auf die Unterseite der Basisstation (Sender) des DECT-Funktelefons (möglichst in die Nähe des Eingangs für das Stromkabel). Kleben Sie einen weiteren Gabriel-Chip auf den Akku des Funkteils (Empfänger). Für jedes zusätzliche Empfangsteil benötigen Sie einen weiteren Gabriel-Chip.



### Babyphone Sender & Empfänger

Kleben Sie einen Gabriel-Chip auf die Unterseite der Basisstation (Sender) des Babyphones (möglichst in die Nähe des Eingangs für das Stromkabel). Kleben Sie einen weiteren Gabriel-Chip auf den Akku des Funkteils (Empfänger).



---

## *Vorbereitung/Anbringung*

Um die Haftfähigkeit des Gabriel-Chips zu optimieren, reinigen Sie vor dem Anbringen die Oberfläche Ihres Geräts sorgfältig. Die Oberfläche des Geräts sollte staub- und fettfrei sein. Ziehen Sie dann die Schutzfolie von der Rückseite des Gabriel-Chips ab und platzieren Sie ihn mit der Klebeschicht an der vorgesehenen Stelle. Drücken Sie den Gabriel-Chip einmal fest an, damit er fest an der Oberfläche haftet.

---

## *Wiederverwendung*

Dieser Gabriel-Chip kann abgezogen und neu aufgeklebt werden. Die Wirksamkeit der Gabriel-Technologie wird dadurch nicht beeinflusst. Möglicherweise verringert sich die Klebefähigkeit des Gabriel-Chips bei mehrmaligem erneutem Aufkleben. Achten Sie deshalb darauf, die Oberfläche vor dem Anbringen zu säubern und die Klebeschicht des Gabriel-Chips nicht zu berühren.